



平成29年7月31日

各 位

会社名 アピックヤマダ株式会社
代表者名 代表取締役社長 押森 広仁
(コード番号 6300 東証二部)
問合せ先 取締役企画部長 小出 篤
(TEL. 026-275-2111)

(訂正・数値データ訂正) 「平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、平成28年8月5日に開示いたしました「平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。

記

1. 訂正内容及び理由

訂正内容及び理由につきましては、本日公表の「過年度の有価証券報告書等及び決算短信等の訂正に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 訂正箇所

訂正箇所が多数に及ぶため、訂正後の全文を添付し、訂正の箇所には下線を付して表示しております。

以上

(訂正後)



平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年8月5日

上場取引所 東

上場会社名 アピックヤマダ株式会社

コード番号 6300 URL <http://www.apicyamada.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 押森広仁

問合せ先責任者 (役職名) 取締役企画部長 (氏名) 小出 篤 TEL 026-275-2111

四半期報告書提出予定日 平成28年8月10日 配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無: 無

四半期決算説明会開催の有無: 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年3月期第1四半期の連結業績(平成28年4月1日～平成28年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第1四半期	1,457	△37.9	△407	—	△433	—	△434	—
28年3月期第1四半期	2,346	0.9	△174	—	△148	—	△153	—

(注) 包括利益 29年3月期第1四半期 △517百万円(—%) 28年3月期第1四半期 △133百万円(—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
29年3月期第1四半期	△34.98	—
28年3月期第1四半期	△12.32	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
29年3月期第1四半期	11,979	2,932	24.5	236.08
28年3月期	13,101	3,449	26.3	277.76

(参考) 自己資本 29年3月期第1四半期 2,932百万円 28年3月期 3,449百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
28年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00
29年3月期	—	—	—	—	—
29年3月期(予想)	—	0.00	—	0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無: 無

3. 平成29年3月期の連結業績予想(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	5,460	34.7	△85	—	△80	—	△100	—	△8.05
通期	12,000	34.8	320	—	350	—	300	—	24.15

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無: 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
新規 一社 （社名） 、除外 一社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料P. 3「2. サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	29年3月期1Q	12,969,000株	28年3月期	12,969,000株
② 期末自己株式数	29年3月期1Q	548,643株	28年3月期	548,510株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	29年3月期1Q	12,420,454株	28年3月期1Q	12,421,811株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続きは終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手できる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績の予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P. 2「1. 当四半期に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
(3) 追加情報	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、米国の内需の底堅きなどから景気回復が続いておりましたが、米国、欧州では内向きの政治リスク、地政学的リスクが高まり、中国などの新興国においては、一時期の急激な景気冷え込みは脱したものの、投資、消費ともに牽引役の不足に伴う経済成長率の鈍化が懸念されています。これらにより、景気の下振れリスクが高まってきました。一方、わが国経済も、企業収益及び雇用・所得環境の回復により、緩やかな回復基調で推移しましたが、世界経済の下振れリスクや、円高といった要因により、不透明感が強まりました。

当社グループの主たる供給先である半導体業界は、当第1四半期連結累計期間前半は在庫調整等により動きには鈍いものがありました。後半より在庫調整が進んだことによる半導体市況の改善、3次元NAND型フラッシュメモリーへの投資等先端向け投資が動き出しました。

こうした環境の中で、当社グループは先期に引続きWLP（ウェハーレベルパッケージ）をはじめとする先端パッケージ分野及び車載向けパッケージ分野など、当社の強みを活かした分野に対して積極的な拡販活動を行いました。

この結果、先期に引続き先端分野を中心に受注はほぼ計画どおりの進捗となりましたが、売上は当第1四半期連結累計期間の売上計画案件が少なかったことを主因として、当第1四半期連結累計期間の売上高は1,457百万円

（前年同四半期比37.9%減）、営業損失は407百万円（前年同四半期は営業損失174百万円）、経常損失は433百万円（前年同四半期は経常損失148百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は434百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失153百万円）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

①電子部品組立装置

電子部品組立装置の受注環境は高機能スマートフォンの需要の頭打ちによる電子部品受注の落込みはありましたが、前述のとおり在庫調整が進んだことによる半導体市況の改善、IoTや3次元NAND型フラッシュメモリーへの投資等先端向け投資が動き出した影響もあり、WLPを始めとする新規パッケージ向けモールド装置の受注が全体を牽引し、ほぼ当初計画どおりの進捗となりました。一方、売上は当第1四半期連結累計期間の売上計画案件が少なかったことを主因として、前年同四半期に比し減少いたしました。

この結果、売上高は1,096百万円（前年同四半期比31.6%減）、セグメント損失は201百万円（前年同四半期はセグメント利益42百万円）となりました。

②電子部品

一般半導体及びLED向けのリードフレーム等の製造につきましては、価格面で厳しい環境が継続しております。また、LEDプリモールド基板事業は、新規顧客開拓及び合理化によるコスト削減を推進しましたが、LED市場の停滞の影響もあり、伸び悩みました。なお、リードフレーム事業において、前年同四半期は、一部の製品で当社の外注加工費用を含む取引がありましたが、商流変更により当第1四半期連結累計期間は外注加工費用を除く取引となっております。この変更により売上は80百万円程度減少しました。

この結果、売上高は261百万円（前年同四半期比50.9%減）、セグメント損失は69百万円（前年同四半期はセグメント損失67百万円）となりました。

③その他

その他につきましては、リード加工金型及びリードフレーム用生産金型の販売であります。リードフレームを使用する半導体の設備投資につきましては慎重であり、リード加工金型は低調に推移しました。

この結果、売上高は99百万円（前年同四半期比52.9%減）、セグメント利益は3百万円（前年同四半期はセグメント損失9百万円）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、11,979百万円（前連結会計年度末は13,101百万円）となり、前連結会計年度末と比較して1,121百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金の減少並びに売掛金の減少によるものであります。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末における負債合計は、9,047百万円（前連結会計年度末は9,651百万円）となり、前連結会計年度末と比較して603百万円減少いたしました。これは主に、支払手形の減少及び短期借入金の減少によるものであります。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は、2,932百万円（前連結会計年度末は3,449百万円）となり、前連結会計年度末と比較して517百万円減少いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上による利益剰余金の減少によるものであります。

なお、これらの要因により、自己資本比率は24.5%（前連結会計年度末は26.3%）となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成28年5月13日の「平成28年3月期 決算短信」で公表いたしました第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はありません。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
会計方針の変更

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる損益に与える影響はありません。

(3) 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を当第1四半期連結会計期間から適用しております。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,460,611	2,052,228
受取手形及び売掛金	<u>2,220,622</u>	<u>1,742,285</u>
商品及び製品	<u>2,207,052</u>	<u>2,740,950</u>
仕掛品	1,894,673	2,095,165
原材料及び貯蔵品	121,654	190,479
その他	<u>130,919</u>	<u>224,935</u>
流動資産合計	<u>10,035,534</u>	<u>9,046,043</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	908,170	874,011
機械装置及び運搬具(純額)	357,452	329,138
土地	488,099	488,099
その他	196,225	183,700
有形固定資産合計	<u>1,949,948</u>	<u>1,874,950</u>
無形固定資産	81,872	77,656
投資その他の資産		
その他	1,038,567	986,001
貸倒引当金	<u>△4,798</u>	<u>△4,798</u>
投資その他の資産合計	<u>1,033,769</u>	<u>981,202</u>
固定資産合計	<u>3,065,589</u>	<u>2,933,809</u>
資産合計	<u>13,101,124</u>	<u>11,979,853</u>
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,761,123	2,143,039
短期借入金	3,162,000	2,740,000
1年内返済予定の長期借入金	244,448	216,746
未払法人税等	<u>18,840</u>	<u>72</u>
賞与引当金	102,597	60,896
製品保証引当金	<u>63,265</u>	<u>58,601</u>
前受金	<u>1,747,007</u>	<u>2,308,877</u>
その他	<u>293,071</u>	<u>330,313</u>
流動負債合計	<u>8,392,354</u>	<u>7,858,546</u>
固定負債		
長期借入金	318,010	282,340
退職給付に係る負債	731,509	711,710
その他	209,294	195,004
固定負債合計	<u>1,258,813</u>	<u>1,189,055</u>
負債合計	<u>9,651,168</u>	<u>9,047,602</u>

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,837,500	5,837,500
利益剰余金	<u>△2,069,628</u>	<u>△2,504,070</u>
自己株式	<u>△100,944</u>	<u>△100,972</u>
株主資本合計	<u>3,666,926</u>	<u>3,232,456</u>
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△5,229	△9,246
為替換算調整勘定	△187,966	△269,691
退職給付に係る調整累計額	<u>△23,773</u>	<u>△21,267</u>
その他の包括利益累計額合計	<u>△216,970</u>	<u>△300,205</u>
純資産合計	<u>3,449,956</u>	<u>2,932,251</u>
負債純資産合計	<u>13,101,124</u>	<u>11,979,853</u>

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)
売上高	2,346,381	1,457,442
売上原価	1,962,948	1,321,147
売上総利益	383,433	136,295
販売費及び一般管理費	558,418	543,742
営業損失(△)	△174,985	△407,447
営業外収益		
受取利息及び配当金	1,659	1,631
為替差益	1,327	—
受取技術料	5,663	2,863
受取補償金	46,093	—
受取賃貸料	6,311	8,920
その他	8,661	6,379
営業外収益合計	69,716	19,795
営業外費用		
支払利息	19,136	17,706
持分法による投資損失	21,658	11,829
為替差損	—	16,125
その他	2,568	417
営業外費用合計	43,363	46,079
経常損失(△)	△148,632	△433,731
特別利益		
固定資産売却益	436	—
特別利益合計	436	—
税金等調整前四半期純損失(△)	△148,195	△433,731
法人税、住民税及び事業税	977	1,032
法人税等調整額	3,918	△323
法人税等合計	4,896	709
四半期純損失(△)	△153,092	△434,441
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△153,092	△434,441

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
四半期純損失(△)	<u>△153,092</u>	<u>△434,441</u>
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,040	△4,016
為替換算調整勘定	15,851	△46,945
退職給付に係る調整額	2,476	2,506
持分法適用会社に対する持分相当額	△810	△34,779
その他の包括利益合計	<u>19,557</u>	<u>△83,235</u>
四半期包括利益	<u>△133,534</u>	<u>△517,676</u>
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	<u>△133,534</u>	<u>△517,676</u>

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			合計
	電子部品 組立装置	電子部品	その他 (注)	
売上高				
外部顧客への売上高	1,602,365	533,456	210,559	2,346,381
セグメント間の内部売上高又は振替高	18,874	6,377	2,370	27,622
計	1,621,240	539,834	212,929	2,374,004
セグメント利益又は損失(△)	42,040	△67,590	△1,821	△27,370

(注)「その他」の区分は、リード加工金型及びリードフレーム生産用金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び該差額の主要な内容(差額調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	△27,370
セグメント間取引高消去	-
全社費用(注)	△147,614
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	△174,985

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			合計
	電子部品 組立装置	電子部品	その他 (注)	
売上高				
外部顧客への売上高	1,096,262	261,975	99,204	1,457,442
セグメント間の内部売上高又は振替高	4	1,582	78	1,664
計	1,096,267	263,557	99,282	1,459,107
セグメント利益又は損失(△)	△201,398	△69,602	3,058	△267,942

(注)「その他」の区分は、リード加工金型及びリードフレーム生産用金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び該当差額の主要な内容(差額調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	△267,942
セグメント間取引高消去	—
全社費用(注)	△139,504
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	△407,447

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントの変更等に関する事項

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

「会計方針の変更」に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間に「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる報告セグメントの利益又は損失に与える影響はありません。

4. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。